

第 20 回エレクトロニクス実装学会講演大会プログラム

会期：平成 18 年 3 月 22 日(水)～24 日(金) 会場：日本大学理工学部駿河台キャンパス 1 号館

第 1 日目 (3 月 22 日)

	【A 会場】		【B 会場】		【C 会場】
		10:00	「電磁特性 & 回路・実装設計技術」 座長：中村 篤 (ルネサステクノロジ) 22B-01 招待講演 マイクロ波工学の超高速・高密度実装技術への展開 ○本城和彦, 石川 亮 (電通大 AWCC)	10:00	「光回路実装技術」 座長：三上 修 (東海大) 22C-01 招待講演 激変するエレクトロニクス産業構造と光技術 ○内田慎二 (東海大科学技術研究所)
10:30	「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長：澤田廉士 (九州大) 22A-01 招待講演 MEMS デバイス開発におけるパッケージングの考察 ○水上友介 (京セラ)	10:30	22B-02 BGA パッケージにおける GHz 高速信号解析方法の提案 ○井上博文, 大島大輔, 古谷 充, 堺 淳 (NEC 生産技術研究所) 石川 亮, 本城和彦 (電通大 AWCC)		
		10:45	22B-03 BGA パッケージ伝送路における電磁界解析手法 ○古谷 充, 井上博文 (NEC)		
11:00	22A-02 MEMS 電鍍コンタクトの高弾性の可能性 ○野田敦人 (日本モレックス)	11:00	22B-04 高速差動信号伝送におけるプリント配線板リフレンス面の影響 ○高橋一平, 中西秀行, 田中顕裕 (アイカ工業)	11:00	22C-02 招待講演 光回路実装技術ロードマップ—光インタコネクション技術の進展と新たな可能性— ○穴倉正人 (日立)
11:15	22A-03 溶融はんだ吐出法による大径バンパ形成技術 ○横山吉典, 福本 宏, 遠藤加寿代, 武田宗久 (三菱電機)	11:15	座長：春木伸男 (リコー) 22B-05 シリアル信号伝送改善 Post-Emphasis 手法における各種条件の考察 ○山岸圭太郎 (三菱電機)		
11:30	22A-04 軟質材料を用いた低荷重コンタクトプロービング ○井上和博 (東大) 片岡憲一 (東京エレクトロン AT) 伊藤寿浩, 須賀唯知 (東大)	11:30	22B-06 プリント基板ベタ面構造の静電気ノイズへの影響 ○草野善之, 山中康弘, 木股浩之, 島寄 睦 (三菱電機)	11:30	座長：穴倉正人 (日立製作所) 22C-03 光バックプレーン用 10 Gbps×4 ch. 光送受信モジュールの設計と評価 ○鈴木 敦, 若園芳嗣, 鈴木健司, 菊地克弥, 仲川 博, 鈴木修司, 山口隆行, 茨木 修, 青柳昌弘 (産総研)
				11:45	22C-04 住宅内シングルモード光ファイバ配線システム用 Wall-plug 光モジュール ○碓氷光男, 石井雄三, 田中伸幸, 平田泰興, 石沢鈴子, 林 剛, 大木茂久 (NTT)
12:00	昼休み	12:00	昼休み	12:00	昼休み
13:00 ～ 13:20	学会賞表彰式 (6F CST ホール)				
13:20 ～ 14:20	特別講演 (6F CST ホール) 「実装技術の歴史的変遷と今後の見通し」 講師：明星大学教授 大塚寛治氏				

第1日目 (3月22日)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
14:30	座長：内海裕一（兵庫県立大） 22A-05 超微細・薄型Cu電極の100万ピンレベル直接接合 ○重藤暁津（東大先端研）伊藤寿浩，須賀唯知（東大）	14:30	「回路・実装設計技術」 座長：浅井秀樹（静岡大） 22B-07 招待講演 三次元電磁界シミュレータの現状と応用 ○田辺英二（エーイーティアー）	14:30	22C-05 マスク転写法を用いた自己形成光ピン ○花島 宏，小幡雄介，小澤秀明，浅野 努，三上 修（東海大）内田禎二（東海大科学技術研究所）
14:45	22A-06 ハイブリッドボンディング（プラズマ表面活性化接合と陽極接合の併用）による低温ボイドレス接合方法 ○山内 朗（ボンドテック）加々見丈二（神港精機）			14:45	22C-06 マスク転写法によりVCSEL上に作製した光接続ロッドの特性 ○神田昌宏，小幡雄介，久保宏行，三上 修（東海大）
15:00	22A-07 Ar高速原子ビームを用いた表面活性化法による常温接合のためのAu薄膜封止構造の検討 ○岡田浩尚，伊藤寿浩，須賀唯知（東大）	15:00	22B-08 電源供給の工夫によるバイパスキャパシタのない0.18 μ mノードCMOSI/Oインターフェースシステムの開発と6Gbps動作の確認 ○秋山 豊（明星大）伊藤恒夫（エクセルサービス）伊東恭二（ルネサス北日本セミコンダクタ）大塚寛治（明星大）	15:00	22C-07 マスク転写光ロッドとファイバとの光接続 ○久保宏行，神田昌宏，花島 宏，小幡雄介，三上 修（東海大）内田禎二（東海大総合科学技術研究所）
15:15	22A-08 振幅制御の機構を持つ外部励振によるマイクロミラーの開発 ○石切山公輔，伊藤寿浩，須賀唯知（東大）前田龍太郎，小林 健（産総研）澤田廉士（九州大）	15:15	22B-09 等価回路によるプリント配線板のストリップ線路のカップリングノイズの解析 ○菊地秀雄（トッパンNECサーキットソリューションズ）	15:15	22C-08 ダイシングを用いたポリマー光導波路フィルムの作製 ○笠原章宏，小田久哉，角田 敦，石田宏司（千歳科学技術大）
15:30	休憩	15:30	休憩	15:30	休憩
15:45	座長：伊藤寿浩（東京大） 22A-09 垂直単位操作型マイクロリアクターの作製と評価 ○藤原邦代，浅野豪文，浮田芳昭，内海裕一（兵庫県大）	15:45	座長：谷 貞宏（シャープ） 22B-10 タイムステップ選択を付随するLIMによる非線形大規模回路網の高速過渡解析 ○坪井典丈，久保田英正，浅井秀樹（静岡大）	15:45	座長：浜野利久（富士ゼロックス） 22C-09 光閉じ込めコア構造を有する多層光導波路基板 ○松岡康信，穴倉正人（日立製作所）柴田智章（日立化成工業）
16:00	22A-10 多機能垂直フィルターの設計と評価 ○浮田芳昭，浅野豪文，藤原邦代，内海裕一（兵庫県大）	16:00	22B-11 多層配線板のパターン熱設計ツールの開発 ○黒川隆志（新電元工業）	16:00	22C-10 チャネル光導波路を用いたボード内チップ間波長多重光配線の提案 ○山口智史，裏 升吾（京都工織大）金高健二（産総研）
16:15	22A-11 人体内通信における電極配置および接触状態の違いによる伝送効率の変動 ○蜂須賀啓介，岸 慶憲，林 勇樹，佐々木 健（東大）	16:15	22B-12 ペア線間遠端クロストーク低減技術の検討 ○佐々木伸一，原 健太郎（佐賀大）	16:15	22C-11 OPLEAFによる光ICとテープファイバの高密度実装 ○広井典良，蘭部 忠（並木精密宝石）藤田博之（東大生産研）竹中 充，中野義昭（東大先端研）
16:30	22A-12 電子基板上に人工筋肉ワイヤーを実装した昆虫型ロボットの研究 ○山本 聡，坪田祥子，宗形亜美，内木場文男（日大）			16:30	22C-12 モールドを用いた自己形成光ピンの簡易作製法 ○徳原拓也，小澤秀明，三村祐介，三上 修（東海大）

第1日目 (3月22日)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
				16:45	22C-13 VCSEL-45度ミラー光配線間の自己形成テーパ接続 ○三村祐介, 小澤秀明, 徳原拓也, 三上 修 (東海大) 塩田剛史 (三井化学)

17:30~19:00 懇親会 於: レストラン・プリオール (中央大学駿河台記念館 1F)

第2日目 (3月23日)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
10:00	<p>「はんだ接続信頼性」 座長：三浦英生（東北大） 23A-01 無電解Ni/Auめっき膜はんだ接合メカニズムの考察 ○金高善史，石塚直美（日本電気）鈴木俊哉，玉林慎一（トッパンNECサーキットソリューションズ）村上朝夫（日本電気）</p>	10:00	<p>「電磁特性技術」 座長：井上博文（日本電気） 23B-01 ブロードサイドカップルドストリップミアンダ線路の遮蔽導体による遅延特性の改善 ○奈良茂夫，越地耕二（東京理科大）</p>	10:00	<p>「配線板製造技術」 座長：柴田正実（山梨大） 23C-01 不溶性アノードを用いた硫酸銅めっき浴の検討 ○萩原秀樹（関東学院大）君塚亮一（荏原ユーザライト）小岩一郎，本間英夫（関東学院大）</p>
10:15	<p>23A-02 Au-Ag合金バンプ/Sn系はんだフリップチップ接合部の信頼性 三上道孝，○有川孝俊（田中電子工業）</p>	10:15	<p>23B-02 電磁ノイズ干渉によるユビキタス機器の通信性能への影響に関する研究 ○岡庭弘典，高橋丈博，作左部剛視，澁谷昇（拓殖大）</p>	10:15	<p>23C-02 厚付け置換型ノーシアン金めっきの検討 ○寺島肇，長島弘季，角田貴徳（関東学院大）小林未奈子，渡辺秀人（小島化学薬品）小岩一郎，本間英夫（関東学院大）</p>
10:30	<p>23A-03 マルチ列QFNの信頼性に及ぼすパラメタの検討 ○金永培，雨海正純（日本テキサスインスツルメンツ）</p>	10:30	<p>23B-03 マイクロストリップ線路における入力信号の再生 ○星敦司，青木広宙，越地耕二（東京理科大）</p>	10:30	<p>23C-03 UV 光質処理を用いたポリイミド上への無電解めっき法 ○石川久美子（関東学院大）松井貴一，井上浩徳（関東学院大表面工学研究所）三浦修平（荏原ユーザライト）小岩一郎（関東学院大）本間英夫（関東学院大表面工学研究所）</p>
10:45	<p>23A-04 はんだ接合部の温度サイクル試験における温度変化率の影響 ○永井孝幸（エスベック環境試験技術センター）青木雄一，辻江一作（エスベック）</p>	10:45	<p>23B-04 デジタル無線通信機器における内部干渉雑音の評価法 ○堀圭吾，風間智（太陽誘電）後藤薫，松本泰（情報通信研究機構）</p>	10:45	<p>23C-04 高アスペクト比スルーホールへの無電解銅めっきの適用 ○井上浩徳，王子雅裕，樋口峰進，小山田仁子（関東学院大）宮崎智行，依田健太郎（日立PWBS）本間英夫（関東学院大）</p>
11:00	<p>23A-05 設計要因の交互作用を考慮した電子デバイスBGAパッケージにおける信頼性設計手法 于強，澁谷忠弘，陳在哲，○近藤悟史，白鳥正樹（横国大）</p>	11:00	<p>23B-05 スルーホールのインピーダンス制御設計手法の開発 ○池田聡，東浦健一，田中顕裕（アイカ工業）</p>	11:00	<p>座長：珍田 聡（日立電線） 23C-05 招待講演 NEDO5ヵ年プロジェクト「次世代半導体デバイス用高密度化実装部材のための基盤技術開発」を振り返って—電気的信頼性の立場から ○吉原佐知雄（宇都宮大）</p>
11:15	<p>23A-06 多重反射波を利用した超薄厚パッケージの非破壊評価 ○上野一也，平野俊介，松永聖剛（コベルコ科研）</p>	11:15	<p>23B-06 磁性体シートを貼った線路の諸特性の測定 ○高橋丈博，作左部剛視，澁谷昇（拓殖大）荒井眞澄（富士プリント）</p>		
11:30	<p>23A-07 エリアアレイ型フリップチップ実装構造におけるバンプ接続不良の非破壊検査方法の提案 ○佐藤祐規，三浦英生（東北大）</p>	11:30	<p>23B-07 プリント配線板の信号導体表面処理と伝送線路の関係 ○八木貴弘，二村和則，芳賀知（沖プリントドサーキット）</p>	11:30	<p>23C-06 めっき皮膜の in-situ 応力測定 ○小山田仁子，本橋甲子明（関東学院大）高橋智賀子，秋山勝徳，山本渡（山本鍍金試験器）小岩一郎，本間英夫（関東学院大）</p>

第 2 日目 (3 月 23 日)

	【A 会場】		【B 会場】		【C 会場】
11:45	23A-08 リフローシミュレーターを使用したバンブ中ポイド発生メカニズムの観察 ○高木寛二 (オムロン) 萬場雄二 (オムロン飯田)	11:45	23B-08 プリント回路における縦型コイル～インダクタンス及び磁界分布の検討～ ○森田昌芳, 青木広宙, 越地耕二 (東京理科大)	11:45	23C-07 塩化第二鉄溶液による回路用銅箔のウェットエッチング特性 ○高橋大喜, 松村和俊, 松本克才, 谷口尚司 (東北大)
12:00	昼休み	12:00	昼休み	12:00	昼休み
13:00 ～ 14:00	特別講演 (6F CST ホール) 「常温接合と接続技術の将来像」 講師: 東大教授 須賀唯知氏				
14:15	「はんだ損傷評価」 座長: 苅谷義治 (物質・材料研究機構) 23A-09 Sn-Ag-Cu はんだ接合部の熱疲労寿命に及ぼす保持時間の影響 ○門田朋子, 向井 稔, 高橋浩之, 廣畑賢治, 川上 崇 (東芝)	14:15	座長: 原田高志 (日本電気) 23B-09 招待講演 EMC 協調統合設計における新しい近傍磁界制御・計測技術 ○山口正洋 (東北大)	14:15	座長: 和嶋元世 (荏原ユーザライト) 23C-08 新規な狭小ランドパターン形成技術の開発 ○入沢宗利, 金田安生, 豊田裕二 (三菱製紙) 深瀬克哉, 酒井豊明 (新光電気工業)
14:30	23A-10 放射光 X 線 CT 装置によるフリップチップはんだ接合構造体の熱疲労損傷評価 ○釣谷浩之, 佐山利彦 (富山県工業技術センター) 高柳 毅, 岡本佳之 (コーセル) 上杉健太郎 (SPring-8/高輝度光科学研究センター) 森孝男 (富山県立大)			14:30	23C-09 ポリイミド一括積層多層配線板におけるペーストビアの高周波伝送特性 ○小澤直行, 伊藤彰二, 佐藤正和, 渡邊裕人, 中尾 知 (フジクラ)
14:45	23A-11 はんだ接合部の衝撃せん断変形にともなう起電力の検討 ○熊沢鉄雄, 中山 昇 (秋田県立大) 坪根健一郎, 伊東伸孝, 安陪光紀 (富士通)	14:45	23B-10 プリント回路基板の幅狭グラウンドから生じるコモンモード放射に対するノイズ抑制シートの効果の実験的検討 ○渡辺哲史 (岡山県工業技術センター) 吉田栄吉 (NEC トーキン) 和田修己 (京都大) 松嶋 徹, 酒井陽平, 古賀隆治 (岡山大)	14:45	23C-10 フィールドビアを適用した多層 FPC “SBic” ○中馬敏秋, 小宮谷寿郎, 石橋幹彦, 近藤正芳, 稲葉 誠, 飯田隆久 (秋田住友ベーク)
15:00	23A-12 BGA 実装基板の温度サイクルによるはんだ損傷のレーザスペックル干渉法および有限要素法による追跡 ○大越孝志, 飯沼裕和, 鯉淵興二 (湘南工大)	15:00	23B-11 車載電子機器のコモンモードノイズ低減技法 ○鶴生高德, 市川浩司, 水野 広 (デンソー) 馬淵雄一 (日立製作所) 林 亨, 中村 篤 (ルネサステクノロジ)	15:00	23C-11 ドライフィルムを用いた LTCC 導体パターンの新たな形成方法 ○山下恭平, 長島理恵, 内木場文男 (日大)
15:15	23A-13 微小抵抗変化によるはんだ接合部のクラック進展評価 ○青木雄一, 辻江一作, 中川泰利 (エスベック) 永井孝幸 (エスベック環境試験技術センター)	15:15	23B-12 PWB における 20 H ルールの有効性 ○柳川知明, 伊神眞一, 櫻井秋久 (日本 IBM)	15:15	23C-12 薄膜プロセスを用いた LTCC 多層配線基板への微細配線形成 ○宮澤英之 (KOA)
15:30	休憩	15:30	休憩	15:30	休憩

第2日目 (3月23日)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
15:45	<p>「電氣的信頼性」 座長：熊沢鉄雄（秋田県立大） 23A-14 パルス静電応力法の紹介と基板用ガラス繊維/エポキシ樹脂複合板の三次元空間電荷分布 ○田中秀郷（早稲田大） 福永 香，前野 恭（情報通信研究機構）岡本健次（富士電機アドバンステクノロジー）大木義路（早稲田大）</p>	15:45	<p>座長：田中顕裕（アイカ工業） 23B-13 MIMO通信の電磁界解析および実測による基礎的検討 ○佐久間 学，青木広宙，越地耕二（東京理科大）</p>	15:45	<p>座長：猪川幸司（日本シイエムケイ） 23C-13 プラズマを用いたデスマリア処理高効率化に関する研究 ○倉橋孝宏（ニッシン） 加藤聖隆（ケイテックリサーチ）</p>
16:00	<p>23A-15 4点曲げ負荷によるMOSFETの電気特性変動評価 ○小金丸正明（福岡工技セ）池田 徹，宮崎則幸（京大）小出康智（福岡大）友景 肇（福岡大）</p>	16:00	<p>23B-14 FDTD法シミュレーション結果の遠方界放射一近傍界分布測定による検証 ○櫻田雅彦，蔦ヶ谷 洋（太陽誘電）庄司寿喜，宮西英司，柳本太加志（リコー）</p>	16:00	<p>23C-14 微細径ドリルの穴加工技術 小林末呉，○渡邊英人（ユニオンツール）</p>
16:15	<p>23A-16 フリップチップ実装構造におけるSiチップ内残留応力の配線パターン依存性 ○上田啓貴，三浦英生（東北大）</p>	16:15	<p>23B-15 プリント配線板電源供給系からのEMI解析モデル ○楠本 学，原田高志，和深 裕（NEC）</p>	16:15	<p>23C-15 実装部品の3次元形状再構成 ○原 靖彦，白井健二，小林義和（日大）</p>
16:30	<p>23A-17 微小導電性接着部の力学的・電氣的特性の評価 ○吉澤幸真，池上皓三（東京電機大）</p>	16:30	<p>23B-16 ドットマトリクス状導波器を有する平面アレイアンテナの検討 ○荒生誠治，越地耕二（東京理科大）</p>		
		16:45	<p>23B-17 LSI設計情報からのEMCマクロモデル（LECCS）の構築 ○近藤洋平（岡山大）和田修己（京都大）佐藤富夫，後藤公太郎，井上淳樹（富士通研究所）古賀隆治（岡山大）</p>		
		17:00	<p>23B-18 GHz帯高速差動信号の評価手法 ○西田義広（東芝）鶴田信博（東芝デジタルメディアエンジニアリング）佐藤雄一（東芝）</p>		

第3日目 (3月24日)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
10:00	<p>「配線板信頼性」 座長：田辺一彦（日本電気） 24A-01 招待講演 高温高湿バイアス試験における樹脂絶縁層の絶縁劣化現象 ○岡本健次（富士電機アドバンステクノロジー）福永 香，前野 恭（情報通信研究機構）</p>			10:00	<p>「材料技術」 座長：高橋昭雄（日立製作所） 24C-01 ポリアミド樹脂を用いたビルドアップ低線膨張樹脂材料の開発 ○森 貴裕，斎藤誠一，福田芳弘，高畑義徳，井出光紀（旭電化工業）藤本公三（大阪大）</p>
				10:15	<p>24C-02 低線膨張性絶縁材料の開発 ○斎藤誠一，森 貴裕，福田芳弘，高畑義徳，井出光紀（旭電化工業）</p>
10:30	<p>24A-02 狭ピッチスルーホール回路を有するFR-4基板材料の銅マイグレーション性に関する検討 ○福田富男，村井 曜（日立化成）</p>			10:30	<p>24C-03 ガラスクロスによる基板高機能化に関する検討 木村康之，権藤義宣，吉川真土，染矢 誠，○藤村吉信（旭シューエーベル）</p>
10:45	<p>24A-03 フレキシブル基板上の微細配線におけるイオンマイグレーションの挙動把握 ○伊澤早苗，千野 満，原 秀和，玉山幸司（ミスズ工業）木村雄二，鈴木 梓（工学院大）</p>			10:45	<p>24C-04 高信頼性多層材料の開発 ○小俣 浩，正木隆義，飛澤晃彦（住友ベークライト）</p>
11:00	<p>24A-04 COF 基材におけるイオンマイグレーション性に関する研究 ○松村保範，菅谷知明（三井金属）</p>			11:00	<p>座長：飯田隆久（秋田住友ベーク） 24C-05 導電性接着剤配線技術を用いたヒューマノイドロボット用皮膚センサの開発 ○井上雅博，菅沼克昭（大阪大産研）河崎俊実，六波羅哲雄（十川ゴム）宮下敬宏（ATR）石黒浩（大阪大）</p>
11:15	<p>24A-05 招待講演 シート状接着剤を用いたフレキシブル多層基板における反り解析 ○三宅 清，福岡孝博，谷川 聡（日東電工）</p>	11:15	<p>「電子部品・実装技術」 座長：本多 進（サーキットネットワーク） 24B-01 部品内蔵基板の実用化検討 ○秋元 豊（トッパンNECサーキットソリューションズ）古屋明彦（凸版印刷）石岡卓，中村博文（トッパンNECサーキットソリューションズ）</p>	11:15	<p>24C-06 液状ソルダーレジストの難燃化 ○池田富美子，石田克義，高橋克彦（フジクラ）</p>
		11:30	<p>24B-02 部品内蔵基板用印刷素子のサイズと特性 ○野村浩功，古屋明彦，河本憲治（凸版印刷）秋元 豊（トッパンNECサーキットソリューションズ）</p>	11:30	<p>24C-07 特定基材におけるレジスト剥離性改善 ○濱田康浩，小谷浩子，村上 滋，日向淳悦（ニチゴー・モートン）</p>
11:45	<p>24A-06 Heat Spreader のパッケージ反りに対する影響評価 ○野口智弘，雨海正純（日本テキサスインスツルメンツ）</p>	11:45	<p>24B-03 受動素子内蔵基板を用いたRFモジュールの設計 ○大島大輔，井上博文，中瀬康一郎（NEC）中村博文，秋元 豊（トッパンNECサーキットソリューションズ）</p>	11:45	<p>24C-08 プリント配線板絶縁層の高周波特性 ○福永 香（NICT）西方敦博（東工大）倉橋真司（愛媛工技センター）</p>

第3日目 (3月24日)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
12:00	昼休み	12:00	昼休み	12:00	昼休み
13:00	「環境調和型実装技術」 座長：林 秀臣 (東大) 24A-07 CT スキャンを用いた鉛フリーはんだによるステンレス鋼エロージョン深さの測定 ○康 松愛 (大阪大) 竹本 正, 西川 宏 (大阪大接合科学研究所)	13:00	座長：西原幹雄 (富士通) 24B-04 Sn-Pb めっきと Sn-Zn-Bi はんだとの接合強度に及ぼす Bi 濃度の影響 ○辻口雅人, 谷川雅信, 三松孝彰, 山田隆之 (シャープ)	13:00	座長：松井孝二 (日本電気) 24C-09 招待講演 2次凝集スラリーの粒子調整と再凝集防止を可能にする T. K. FILMICS ○澁谷治男 (プライミクス)
13:15	24A-08 Chop めっきによる Sn Whisker 成長の抑制検討 ○羽生和隆, 渡辺芳久, 平鹿諭子 (ソニー) 気賀智也 (ソニー EMCS 幸田テック)	13:15	24B-05 耐熱鉛フリーはんだ付け部の IMC 検証と観察 ○加藤力弥 (千住金属)		
13:30	24A-09 鉛フリーはんだ印刷ペーストの水素プラズマリフロー工程観察 ○西 修一, 日暮栄治, 須賀唯知 (東大) 萩原泰三, 竹内達也, 新海吉治 (神港精機) 山形咲江, 加藤力弥, 荒瀬和弘 (千住金属工業)	13:30	24B-06 高温用鉛フリーはんだ Zn-Sn 合金と Cu 基板との接合界面と引張特性 ○李 在彦 (大阪大) 金 権鉄, 井上雅博, 菅沼克昭 (大阪大産業科学研究所)	13:30	24C-10 招待講演 ポリマー・クレイ・ナノコンポジットの開発と応用 ○臼杵有光 (豊田中央研究所)
13:45	24A-10 有機亜リン酸を母材とする Pb フリーはんだ用フラックスの開発 ○岡田直記, 柴 隆一 (東京電大)	13:45	24B-07 酸素プラズマ処理した基板へのインクジェット法による抵抗膜の作製 ○坂井雄一, 二口友昭 (富山県工技セ)		
14:00	24A-11 大型 UV 装置を用いた ABS 樹脂の改質処理 ○田代雄彦, 清田浩之, 杉本将治 (関表研) 別所 毅 (トヨタ自動車) 小岩一郎, 本間英夫, (関表研, 関東学院大)	14:00	24B-08 インクジェット法による抵抗体の形成 ○山田啓啓, 黒沢弘文 (セイコーエプソン) 神代 恭, 山本和徳, 丸山直樹 (日立化成工業)	14:00	24C-11 半導体三次元実装構造用銅めっき薄膜の強度物性ゆらぎメカニズムの解明に関する研究 ○作谷和彦, 大塚優哉, 玉川欣治, 三浦英生 (東北大)
14:15	休憩	14:15	24B-09 無電解 Au めっき基板におけるワイヤ接合性 ○高田満生, 安原和彦 (田中電子工業) 戸塚崇志, 和知 弘 (日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ) 花田信一, 向山光一郎 (田中電子工業)	14:15	座長：熊倉俊寿 (日立化成工業) 24C-12 配線用銅薄膜の低サイクル疲労き裂の発生および進展特性 ○梅村優樹, 坂根政男 (立命大) 塚田 裕, 寺田健司 (京セラ SLC)
14:30	「半導体パッケージ技術」 座長：西 邦彦 (日立) 24A-12 ウェーハレベル三次元集積化技術の開発 ○福島誉史, 山田祐介, 菊池宏和, 田中 徹, 小柳光正 (東北大)	14:30	24B-10 ナノペーストを用いたバンプ接合の基礎検討 ○深澤圭一, 黄 啓新 (神工大)	14:30	24C-13 電解銅箔上の無電解 Sn めっき膜より発生するウィスカ ○藤井祐子, 岡本尚樹 (大阪府大) 栗原宏明 (三井金属) 近藤和夫 (大阪府大)
14:45	24A-13 超薄型高密度基板 MLTS の FC 実装パッケージへの展開 ○渡辺 真司, 百川 裕希, 藤村 雄己, 村上朝夫 (日本電気)	14:45	24B-11 樹脂をコアとするハンダ接合材料における樹脂の応力緩和機構 ○松下清人, 奥田正己, 沖永信幸 (積水化学工業)	14:45	24C-14 扁平金属粉体を骨材に用いたシート状複合材料の開発 ○石井裕史, 内木場文男 (日大)

第3日目 (3月24日)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
15:00	24A-14 水冷式コールドプレートの流路構造最適設計 ○石田智隆, 吉川 実, 北城 栄 (日本電気)			15:00	24C-15 高結晶性 Pt 粉末を用いた導電性ペーストの特長 ○村橋大輔 (ノリタケ機材)
15:15	休憩			15:15	休憩
15:30	「ウイスキー信頼性」 座長: 津久井 勤 (東海大) 24A-15 鉛フリーはんだ付け部におけるウイスキー発生要因の一考察 ○田辺一彦 (NEC インフロンティア) 豊田良孝 (千住金属工業) 戸島 寛 (NEC インフロンティア)			15:30	座長: 三澤英人 (松下電工) 24C-16 炭素系超微粉末を用いたシート状電気二重層素子の開発と評価 ○中野悠司, 内木場文男 (日大)
15:45	24A-16 Sn めっき皮膜のウイシカ評価方法 ○辻本雅宣, 梁田 勇 (上村工業)			15:45	24C-17 Cu/Cr/Polyimide 銅張積層板の界面密着強度に及ぼす熱処理の影響 ○宮村剛夫, 小池淳一 (東北大)
16:00	24A-17 鉛フリー Sn めっきより発生する Sn ウイシカの結晶構造と成長方位の TEM 解析 ○浅井 正, 北村幸子, 気賀智也, 谷口芳邦 (ソニーエムシーエス) 森川浩志, 隅山兼治 (名工大)			16:00	24C-18 ポリイミドフィルム上 SrTiO ₃ 薄膜キャパシタの信頼性評価 ○石井康博, 森 透, 渋谷明信, 竹村浩一 (日本電気)
16:15	24A-18 外力による Sn 系メッキのウイシカ発生評価に関する研究 ○山下拓馬, 澁谷忠弘, 于 強, 白鳥 正樹 (横国大)			16:15	座長: 海老塚守之 (ソニー) 24C-19 ITO 薄膜の破断伸びに対する基板収縮の影響とプライマー層による改善 ○渡邊雅人, 小池淳一 (東北大)
16:30	24A-19 Sn ウイシカ発生に及ぼすめっき形態及び端子材質の影響 ○寄門雄飛, 金 檉銖, 菅沼克昭 (大阪大産業科学研究所) 辻本雅宣, 梁田 勇 (上村工業)			16:30	24C-20 アルミニウムによる透明電極薄膜 (ITO, IZO) の還元 ○山浦 潔 (ソニー)
16:45	24A-20 外部応力によるコネクタウイシカ試験方法 (その2) ○藤野秀人, 銅谷明裕 (山一電機)			16:45	24C-21 LTCC 基材に対するめっき処理薬品への影響 ○工藤喜美子, 下地輝明, 村田俊也 (奥野製薬工業)